

Hi3516DV300 功耗测试报告

文档版本 00B01

发布日期 2019-01-15

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明



(上) AISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516D	V300

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

文档版本 00B01 (2019-01-15)

第1次临时版本发布。

前	言	i
 1 Hi	3516DV300 功耗测试结论	1
	i3516DV300 功耗测试环境及说明	
1.2 4	为耗测试场景以及相应的功耗数据	1
1.2.1	场景 1: 智能业务+媒体业务	1

1 Hi3516DV300 功耗测试结论

注意

本测试报告仅用于分享基于当前测试样本和环境的客观记录,从而为客户自行测试做一定程度的参考,测试结果不代表对任何规格、功能、性能等的承诺,也不具备任何约束力。如有疑问,可核对芯片手册。

1.1 Hi3516DV300 功耗测试环境及说明

测试对象	HI3516DV300DMEB 单板		
摄像头	IMX335		
测温设备	点温计		
加温设备	高低温箱,测试温度为芯片结温约 45℃和 105℃		
主芯片散热方式	单板放置于温箱中,依靠 PCB 和芯片表面对流散热。		

1.2 功耗测试场景以及相应的功耗数据

1.2.1 场景 1: 智能业务+媒体业务

智能业务

全速跑 VGG16 NNIE 智能业务。



媒体业务

- 模式: VI 在线 VPSS 离线;
- VI: 2592*1536@30fps 输入 + 2 合一行模式 WDR + PIPE 开启行压,通道开启段压 +ISP 开启 DE, VI 送 VPSS;
- VPSS: 3 个通道非压输出(2592*1536@30+1024*576@30+720*480@30) + 开启 VPSS 的 NR+ 组叠加两个马赛克+ VPSS 的 0 通道旋转 90°, VPSS 送编码和 VO 预览;
- VEDU: 3 路 H26x 编码(H265 SmartP 2592*1536@30fps 8Mbps + H264 NormalP 1024*576@30fps 1Mbps + H264 NormalP 720*480@30fps 512Kbps)+ 一路 Jpeg 编码(2592*1536@2fps)+编码各通道上面叠加时间通道号;
- 1 路大码流点播;
- IVSMD: 720*480@15fps;
- 音频: 1 路音频 32K 采样率 16bit 位宽 AAC 协议开 AGC、ANR 和 AEC;
- 频点: CPU:900MHz/VICAP:396MHz/VIPROC:300MHz/VPSS:300MHz/VGS:475MHz/JPGE:396MHz/IVE:475MHz/VDP:300MHz/DDR:900MHz。

表1-1 各个温度节点下的场景 1 功耗数据

芯片结温	Core 功耗 (mW) DVDD	VDDIO_DDR (mW)	DVDD18 (mW)	DVDD33 (mW)	总功耗 (mW)
55℃(注1)	923	312	18	144	1397
105℃(注 2)	1564	352	26	145	2087

□ 说明

- 注1: 正常照度下功耗
- 注 2: 低照度下 DDR 占用率约为 65%、CPU 占用率约 99% 时功耗